

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2022-008

天水华天科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	

办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号
传真	0938-8632260	0938-8632260
电话	0938-8631816	0938-8631990
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

2021 年是半导体行业大发展的一年，全球半导体行业保持高景气度。在集成电路国产替代、5G 建设加速、消费电子及汽车电子需求增长等有利因素带动下，我国集成电路需求维持高景气度，并继续保持稳定增长，2021 年我国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021 年我国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长 19.6%；制造业销售额为 3,176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额为 2,763 亿元，同比增长 10.1%。随着国家及地方支持集成电路产业发展政策的出台、实施，将有力促进我国集成电路产业发展，集成电路企业将迎来新的发展机遇。

2021 年，公司坚持“用户至上，质量第一”的发展理念，持续关注集成电路行业发展及市场需求情况，紧抓市场机遇，通过合理组织生产，提高设备效率，努力满足客户产品封测需求，公司实现了快速发展。2021 年，公司共完成集成电路封装量 496.48 亿只，同比增长 25.85%，晶圆级集成电路封装量 143.51 万片，同比增长 33.31%，实现营业收入 120.97 亿元，同比增长 44.32%；归属于上市公司股东的净利润 14.16 亿元，同比增长 101.75%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	29,974,351,599.53	19,309,122,269.13	55.23%	16,044,968,730.79
归属于上市公司股东的净资产	15,049,446,789.13	8,506,631,614.77	76.91%	7,768,107,631.71

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	12,096,793,328.40	8,382,084,225.00	44.32%	8,103,490,628.12
归属于上市公司股东的净利润	1,415,671,366.19	701,709,840.59	101.75%	286,794,698.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,100,632,762.23	531,812,331.74	106.96%	151,608,683.08
经营活动产生的现金流量净额	3,444,362,299.00	2,058,108,186.81	67.36%	1,765,034,058.08
基本每股收益（元/股）	0.5025	0.2561	96.21%	0.1134
稀释每股收益（元/股）	0.5025	0.2561	96.21%	0.1134
加权平均净资产收益率	14.04%	8.70%	5.34%	4.30%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,597,315,508.30	3,021,107,326.80	3,248,658,422.26	3,229,712,071.04
归属于上市公司股东的净利润	281,855,420.01	330,825,465.92	415,295,735.19	387,694,745.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,720,196.15	262,969,262.80	340,719,986.88	281,223,316.40
经营活动产生的现金流量净额	611,701,161.76	864,505,759.85	968,541,279.80	999,840,514.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	356,396	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	342,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	20.85%	668,278,455	0			
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	3.21%	102,914,400	102,914,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	56,807,865	0			
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.13%	36,247,723	36,247,723			
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	31,056,466	31,056,466			

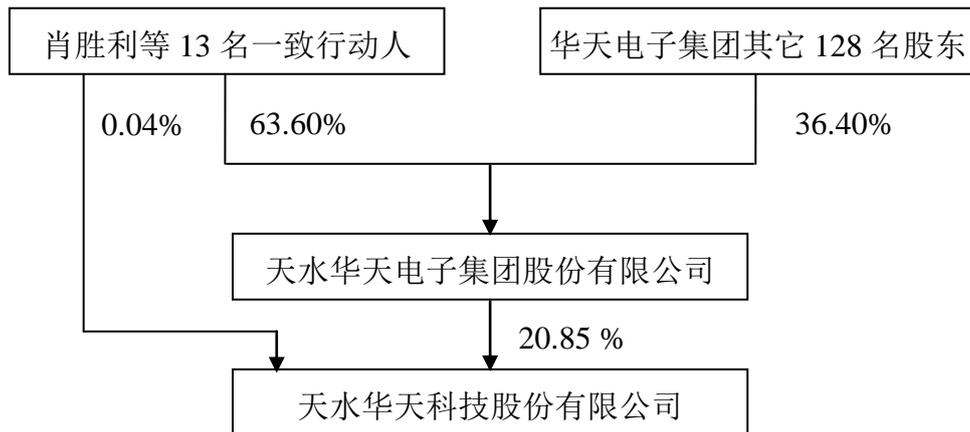
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	27,322,404	27,322,404		
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	其他	0.85%	27,322,404	27,322,404		
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)—盛宇致远 2 号私募证券投资基金	其他	0.77%	24,590,163	24,590,163		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	22,775,869	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.65%	20,849,823	18,397,085		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中, 天水华天电子集团股份有限公司在报告期末共有 28,194,000 股公司股份通过中国证券金融股份有限公司证券转融通借出。 前 10 名股东无限售流通股股东中, 易建东在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 13,700,656 股; 周立功在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 8,000,074 股; 莫常春在报告期末通过普通证券账户持有公司股份 85,700 股, 通过投资者信用账户持有公司股份 7,272,522 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2021 年公司主要工作开展情况如下：

1、做好重点客户的服务工作，努力满足市场和客户需求。

报告期内，在行业景气度持续提升的背景下，公司及子公司 Unisem、华天西安、华天南京、华天昆山等公司加快扩产设备的产能释放，以满足客户的订单需求，重点客户、重点产品稳步上量，客户合作关系稳步提升。继续进行战略客户开发和客户结构优化工作，在产品结构上，Memory、CIS 等应用业务占比继续增加。

2、进一步提升公司质量水平，夯实“零缺陷和全面质量管理”的质量文化。

公司持续进行质量品牌提升工作，通过实施一体化 IATF16949 体系认证，积极推行“质量管理数字化和信息化”，引入“精益六西格玛”方法进行良率提升、效率改进和新技术攻关，不断提高产品质量和管理效能。报告期内，公司通过英飞凌的认证和封装产品验证，TSV、WLP 封装持续通过安森美、安世的 VDA、RBA 认证，与博世的 MEMS 产品实现量产，Memory 封装通过小米、OPPO、VIVO 等终端客户认证。

3、加快先进封装技术和产品的研发以及量产工作，不断提高公司技术水平和创新能力。

完成大尺寸 eSiFO 产品工艺开发，通过芯片级和板级可靠性认证。3D eSinC 产品、Mini SDP、1 主控+16 层 NAND 堆叠的 eSSD、基于 176 层 3D NAND 工艺的 SSD、NAND 和 DRAM 合封的 MCP、Micro SD、硅基 GaN 封装产品等均实现量产。完成单颗大尺寸 HFCBGA、基于 Open Molding 工艺的大尺寸 FCCSP 产品开发。5G FCPA 集成多芯片 SiP 等 5G 射频模组实现量产，完成 EMI 工艺技术研发和产品导入，具备量产能力。

本年度公司共获得授权专利 34 项，其中发明专利 6 项，荣获 2021 年度甘肃省专利奖三等奖。公司子公司华天昆山参与的“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”项目荣获 2020 年度国家科学技术进步奖一等奖。

4、与供应商协同开发验证多项关键封装材料和设备，保障供应链安全。

与封装材料企业、设备制造企业协同合作，完成 MSL1 框架、高端 FCBGA 基板、塑封料、DAF 等封装材料的导入以及划片、上芯、压焊、塑封等主要封装设备国产化应用的验证，保障了供应链安全。

5、完成 2021 年度非公开发行股票融资工作，为公司募集发展所需资金。

报告期内，公司完成非公开发行股票融资工作，募集资金净额 50.48 亿元，所募集的资金用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目及补充流动资金，募集资金投资项目的顺利实施，促进了公司经营规模和盈利能力的提升。

6、持续开展业务流程变革和数字化转型工作，推动公司运营管控体系建设。

以市场销售、技术研发、生产制造、IT 和数据治理为核心突破口，完成战略规划到执行流程、市场洞察流程建设及能力提升、面向高端客户拓展运作、IT 治理体系建设等变革项目

的实施，启动了客户与销售流程、技术研发流程、生产制造流程、数据治理体系建设等变革项目，持续关注创新焦点和关键业务举措，加快推进公司数字化转型，稳步提升公司管理能力和运营效率。